证券代码：301369　　证券简称：联动科技

佛山市联动科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投2026-011

投资者关系活动类别	☐特定对象调研　☐分析师会议 ☐媒体采访　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　☐路演活动 ☐现场参观　☑电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信建投、华福证券、麦格理、国泰海通、长江证券、申万宏源证券、稻沣投资、中航证券、华源证券、方正证券、东吴证券、弘康人寿、瑞银证券、证券时报、前海联合基金、诚域基金、光大证券、中邮证券、光大保德信投资部、银河基金、东方阿尔法基金、建信基金、睿远基金、诺安基金、嘉合基金、银河证券、平安基金、汇丰晋信、汇添富基金、国联基金、长信基金、国海富兰克林基金、富国基金、国金基金、中邮人寿、安信基金、中银基金、国联安基金、东方证券、长信基金、中信保诚、易方达基金、永赢基金、中金基金、新华基金、中金公司、金鹰基金、国盛证券、西南证券、浙商证券、宝盈基金、国海证券、甬兴证券、阳光资产管理股份有限公司、天风证券、航信资本、浙江丰道资本、泉果基金、佰耀资本、高盛中国
时间	2026 年 10 月 28 日 10:00-11:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 邱少媚 投资者关系 王佳颖

投资者关系活动主要内容介绍	介绍了公司的基本情况并回复了投资者关注的主要问题，具体如下： 1、 公司SOC测试机与天数智芯围绕GPU算力芯片验证的最新进展如何？ 答：目前，公司已经与天数智芯达成战略合作，双方正围绕GPU算力芯片及测试技术领域开展协同工作，共同推进量产验证流程、良率调试及效率提升等关键环节的配合工作，整体进展顺利。除天数智芯外，公司也持续与其他AI端侧芯片企业、算力企业以及非AI侧集成类SoC产品客户沟通与接洽。 2、AI SOC测试机量产后机台对公司收入和利润带来哪些影响？ 答：AI SOC测试机单价较传统产品有显著提升，规模化量产后，预计将对公司收入和利润增长形成明显拉动。公司已针对2027年规划进行前置化的产能储备，并依据预期提前储备部分核心零部件。该产品对标海外龙头产品，定价会根据配置和性能实行差异化策略。目前产品尚未量产，预计待产品正式量产后，将会对公司经营业绩产生积极贡献。 3、Northstar境外相关流程是否已经完成？后续交割时间大概如何安排？ 答: 本次交割事项主要涉及商务部门及发改委的境外投资备案程序。待备案完成后，公司将办理外汇登记及后续交割相关手续。目前各项工作进度符合预期，后续如有进一步进展，公司将及时通过公告形式向广大投资者披露。 4、若Northstar交割完成后，J800产品国产化落地时间表及国内客户验证规划如何？ 答: 尽管交割手续尚未完成，双方已就J800机台国产化落地事项展开前期接洽，机台导入及客户对接工作均在有序推进。

	公司已与OSAT厂及潜在头部客户进行交流，机台预计在交割完成后落地国内，并开始向客户进行demo机送样。落地后将同步推进性能升级，规划通过阶段性的性能迭代，逐步拓展至更多、更广泛的存储类型客户群体。 5、公司目前功率和数模产品的交期大概是多久？ 答: 当前下游需求景气度持续向好，公司功率与数模产品两大传统业务的交期在3至4个月左右，属于行业历史上的较长区间。 6、公司如何看待半导体测试设备行业景气度以及后续趋势？ 答：根据SEMI数据，2025年全球半导体测试设备同比大幅增长48.1%至112亿美元，2026年测试设备销售额预计继续增长超过12.0%。从产品结构看，测试机是半导体测试设备中价值量最高的细分领域，其中SoC测试机是最大品类。 随着AI算力、先进封装、存储、汽车电子及功率半导体等需求的持续提升，测试环节的重要性日益显现。芯片复杂度、功耗和封装集成度提升，对测试时间、测试成本、温控能力、老化测试、系统级测试（SLT）及数据处理等方面提出了更高要求。 我们认为，一方面在国内半导体自主可控的大背景下，测试设备迎来了良好的发展机遇；另一方面，随着半导体行业景气度持续上行，测试设备行业具备长期成长空间。公司将依托持续创新，不断丰富产品矩阵，增强半导体自动测试设备的技术实力，全面提升公司的盈利能力。 7、公司传统业务所处市场景气度是怎样的趋势？ 答：在功率市场方面，随着国内外碳化硅晶圆在产能建设、良率提升、技术突破等方面持续取得进展，下游应用涵盖数

	据中心AI电源、新能源汽车、储能和光伏新能源以及工业控制等领域，碳化硅模块国产化率的稳步提升，将有力拉动晶圆测试、KGD测试以及模块测试环节的需求增长。同时，公司在氮化镓测试技术领域也积累了深厚储备，针对氮化镓晶圆和器件的QT-8400系列测试设备已实现批量出货。 展望未来，消费类电子的复苏和多元化应用的持续拓展，也将为公司模拟测试设备的市场开拓创造有利条件。公司始终坚持战略聚焦与市场拓展双轨驱动，持续深耕大功率器件、模块及第三代半导体测试领域，与国内外头部企业保持深度合作，在巩固存量订单的同时积极拓展新客户。 8、海外客户目前收入占比大概是多少？公司在设备出海和海外布局上有什么规划？ 答：根据半年度报告披露数据，出海机台占营业收入接近15%，预计前三季度不会有太大变化。 从订单能见度来看，海外机台与国内差异不大，行业整体仍处于规划扩产阶段。公司在海外客户的拓展方面已陆续取得新突破，例如KGD机台出货至博世，并在碳化硅、传统功率机台方面实现新客户突破，未来有望进一步提升海外客户份额占比。 对Northstar的并购也有助于公司在海外生产线上进行新的战略布局。Northstar在菲律宾拥有一条较完善的生产线，公司计划在并购整合完成后，利用菲律宾当地的生产线直接向海外客户提供传统功率及模拟机台。 9、公司的研发费用较高主要是什么原因？ 答：公司坚持创新驱动发展的战略，持续推动技术升级与产品迭代，自主研发的功率半导体测试系统已成功实现进口替代。公司保持高强度研发投入，前三季度研发费用达1.18亿元，同比增长51.12%，占营业收入比重达31.33%，主要系研发人

	员扩充以及研发耗用材料增多所致。公司研发队伍持续壮大，深耕功率、模拟、数模混合及SoC等关键测试领域，依托系统化、信息化的研发管理体系，高效驱动产品迭代升级与前瞻性布局，为持续提升市场竞争力、服务国家半导体产业战略提供了坚实的技术保障。在巩固现有细分领域产品技术优势的基础上，公司重点开拓数字/数模混合集成电路测试系统的研发方向，进一步拓展技术纵深与市场空间。 10、随着第三代半导体行业上量，公司相关业务有什么增长目标？未来增长的驱动因素有哪些？ 答：公司在第三代半导体测试领域的市占率有望持续提升，核心驱动因素包括： 第一，公司客户结构优质，覆盖全面。公司核心客户覆盖芯联集成、中车、长飞、三安等国内主流第三代半导体功率企业，同时也覆盖部分海外客户。 第二，八寸碳化硅晶圆产能逐步释放，测试需求显著扩容。一方面八寸晶圆的芯片数量较六寸晶圆提升约1.7倍，直接拉动晶圆测试（CP）需求增长；另一方面随着碳化硅模块渗透率提升，KGD测试、模块高低温及常温测试等新增需求明显放量，将显著拉动测试设备需求。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 28 日